



藤井 修治 「柔らかい物質群(液晶・高分子・泡など)の粘弾性測定」

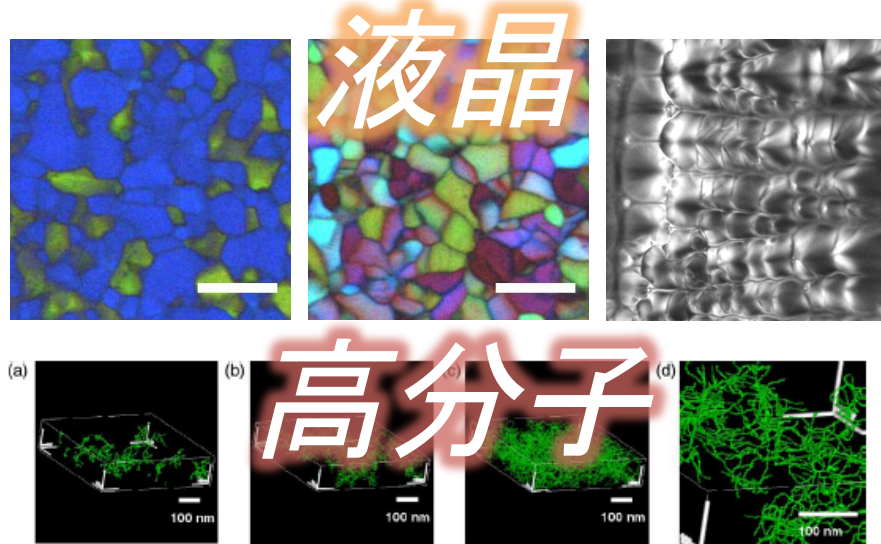
工学研究院応用物理学部門・ソフトマター工学研究室

email: sfujii@eng.hokudai.ac.jp 内線 6640、

研究室HP <http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/MOLPHY/home/index.html>

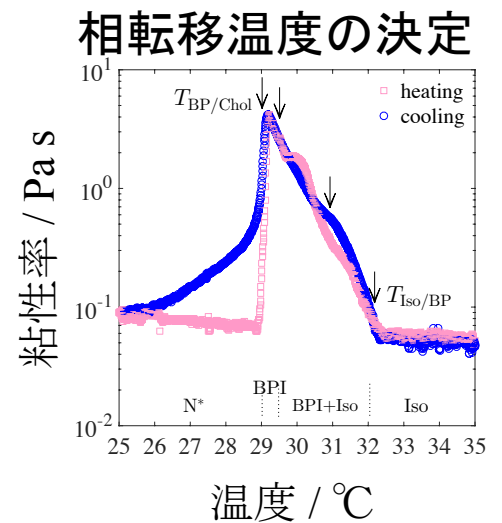
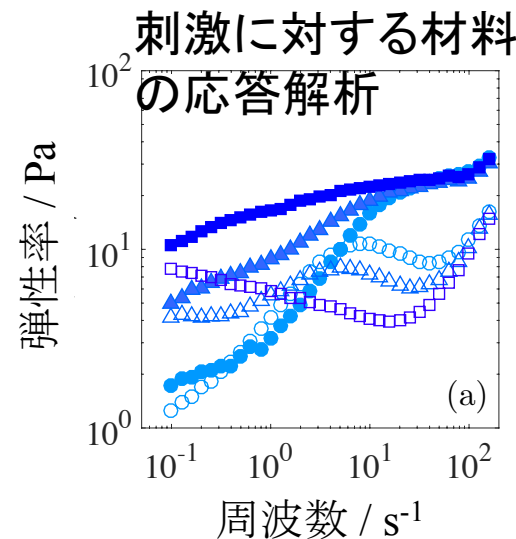
出身地 青森県

高分子、液晶、泡 など “柔らかい物質群” の
弾性率・粘性率測定ができます。



粘弾性スペクトル

粘性率の温度応答



<社会実装への可能性> (3点以内)

食品などのテクスチャ解析と、
粘弾性キャラクタリゼーション

新しい食感・触感を持つ食品・材料の
解析